

2025 第二届高导热材料技术与应用大会

目前，新能源汽车、消费电子、AI、无人机、通讯、电力及工业自动化等正在高速发展，而这些行业正面临着日益严峻的散热难题。消费电子和通信领域，器件小型化、高频化和高功率化趋势下，热量聚集引起的电子产品故障问题；新能源汽车以及储能领域，电池高密度引发的过热安全问题；无人机 CPU、GPU 等高热源带来的可靠性问题……散热正成为制约这些行业技术与产业同步发展的核心难题已成为行业共识，而接下来 AI 技术的赋能无疑将给这些领域带来更猛烈的散热挑战！

目前普遍认为，开发高导热材料是解决散热问题的重要策略。同时，重视研究石墨烯、金刚石、石墨、氮化铝、氮化硼、氧化铝等材料被认为是从基础层面解决散热难题的关键所在。

在此背景下，中国粉体网将于 **2025 年 5 月 28 日** 在江苏·苏州举办**第二届高导热材料与应用技术大会暨导热填料技术研讨会**，大会旨在为导热材料领域搭建技术交流、信息互通的沟通平台，促进导热材料行业技术与产业发展突破。大会热诚欢迎国内外相关领域的专家、学者、科研人员、企业界代表积极参会，同时欢迎公司、企事业单位展示技术成果，洽谈产、学、研合作

.....

时间：2025 年 5 月 28 日全天会议，5 月 27 日全天报到

地点：

江苏苏州 苏州合景万怡酒店

主办单位：

中国粉体网

会议主题：

- 1、新能源汽车、消费电子、无人机、AI 等行业对散热材料的需求现状与发展前景
- 2、热界面材料行业发展现状
- 3、热沉材料技术与应用讨论
- 4、金刚石、石墨、石墨烯等碳材料在导/散热领域的应用及技术现状
- 5、氧化铝、氮化硼、氮化铝、金属粉体等导热填料的制备与改性
- 6、高导热高分子材料研究与开发进展
- 7、高导热散热基板技术与产业化现状
- 8、各类导热材料导热性能调控与设计

9、前沿材料研究成果与应用前景分享的制备与应用

7，抛光磨料纳米化技术发展现状

8，抛光垫等重要耗材的制备及应用现状

9，研磨抛光材料与技术的高端装备精密部件加工中的应用

特色活动：

大会征集参会企业相关技术合作、产品采购，工艺方案等需求进行现场采配活动，相关信息将进行展板展示，提高现场沟通交流效率！

征集内容包含但不限于以下几点：

- 1、行业投资、融资需求
- 2、科研成果转化
- 3、产品工艺问题解决方案
- 4、原料、设备、仪器采购需求

.....

会议费用：

2800 元/人

开户行：中国银行股份有限公司临沂北城支行

帐 号：233841636876

户 名：山东中粉会展服务有限公司

大会赞助：

（赞助详细内容请联系会务组了解）

- 1、协办赞助（含展位、企业致辞，会场后方巨幅广告，视频播放，企业报告等）
- 2、晚宴赞助（含展位、晚宴大屏展示、晚宴致辞、主持人口播广告等）
- 3、其它赞助（会议礼品、环屏广告、侧屏广告，茶歇、椅背广告、胸牌广告赞助等）
- 4、展位展示（展示桌椅+展位背景墙广告）

会务组：

联系人：刘文宝

联系方式：13693335961（同微信）



